

STEM 與永續發展人才培育

【半導體產業入門班】

第 1 梯次

招生簡章

主辦單位 | 國立陽明交通大學、陽明交大雷射系統研究中心

訓練領域 | 數位資訊

訓練職類 | 電腦系統設計及分析

課程時數 | 90 小時

課程時間 | 2026/1/31 (六)~2026/4/20(一)

上課時間 | 每週一、三晚上 18:30-21:30

每週六早上 9:00~12:00

上課地點 | 遠距教學

訓練費用 | 請加官方 [line@](#) 諮詢。※本班為自費課程，無補助。

報名期間 | 即日起 至 2026/1/22 (四) 23:59

課程諮詢 | 陽明交大雷射系統研究中心 鄭小姐 0933-906-833 或

Email 至 nycuitstem@gmail.com

[line@](#) 諮詢，或 Line ID 搜尋 @nycustem

招生網站 | <https://it.stem.lasercenter.nycu.edu.tw/>

※本班最低開班人數：25 人



■ 課程簡介

近期 COVID-19 病毒肆虐全球，反而更加凸顯台灣半導體產業鏈的重要性，不但具有完整上中下游，其產值更佔全球半導體產業將近 20%。除了 5G 與 AI 等應用帶動更多需求，再有中美貿易國際情勢下，導致轉單效應持續加速，使得台灣從 IC 設計到晶元代工再到封裝測試產業一片榮景。台灣半導體產業 2022 年產值已突破 4 兆元新高，產業蓬勃發展，卻出現人才荒。力積電董事長黃崇仁：『全球晶圓代工產能不足會持續到 2022 年之後，原因包括需求成長率大於產能成長率；且包括 5G 及 AI 等應用帶動更多需求。然而建造新晶圓廠成本高昂且至少需時三年以上，期待新產能緩不濟急，產能吃緊已經到了客戶會恐慌的情況。』因此面對如此龐大的產能需求，半導體領域科技人才亦是供不應求。根據 104 人力銀行在 2024 年 8 月新聞稿報導，半導體徵才在 2024 年第二季平均每月徵才 2.6 萬人，隨著半導體大廠往中南部設廠，中南部工作機會佔比也突破 30%。

國立陽明交通大學在過去幾十年間，在半導體產業方面，皆扮演著領航者的角色。於 1958 年首先設立電子研究所，協助政府發展半導體工業。其間設立半導體中心、奈米元件國家實驗室 (National Nano Device Laboratories)，以及台積電、聯發科、鴻海等多家知名科技大廠之專屬研究中心，發展前瞻次微米半導體製程技術，培養半導體產業所需人才，除了教師參與研究外，也培養了無數創業校友，奠定了台灣半導體產業的基礎。陽明交大為了培育更多的實務型科技人才，透過本計畫培養半導體領域之核心知識與素養，規劃半導體領域之課程，提供非領域，但想嘗試跨入半導體產業的人，也能有學科上的學習，提升國內產業人力供給及競爭力問題。

■ 適合對象

1. 無相關程式基礎，不熟悉產業科技知識，對半導體領域有興趣者。
2. 想進入半導體領域，並有跨域或轉職意願，還在尋找方向者。
3. 目前在職中或待業中 55 歲以下對本課程有興趣者。

■ 課程目標

1. 陽明交大目標針對先進半導體製程產業，設計前瞻的跨領域人才培育計畫 (Science-based practical talents for advanced semiconductor industry.)，培

養專業知識包含半導體(Semiconductor)、人工智慧(Artificial intelligence)、光電(Photonics)，簡稱 SAP 科技實務人才培育。

2. 洞察國內外半導體產業之脈動，瞭解時事議題與工程技術對環境、社會及全球之影響，以培養學員成為立足於全球之半導體科技人才。
3. 協助對半導體有興趣者半導體基礎知識，提昇產業競爭力

■ 課程特色及優勢

1. 本課程設計強調半導體產業應用為目的，因應經濟發展之趨勢，在教學發展目標與特色上，高度整合教學資源與師資，效率化提升多元化半導體專業人才培訓養成。本課程有助於培養微電子積體電路領域的應用工程師和研究型學者，並專注於先進微電子晶片電路的研究，以解決國內半導體產業的人才短缺的問題。本課程的教育目標在養成未來多元半導體產業人才，透過多樣的專業課程，使學生成為在元件設計、可靠度分析、量子物理、材料科學與奈米製程技術上具備良好專業知識的整合人才，並透過堅強的專題研究群，引導學生投入前瞻固態電子元件領域，訓練嚴謹的研究能力與創新思維。
2. 上課方式：概念引導與範例應用學習，部分課程搭配電子白板授課，提供講義電子檔，課程皆會進行錄影，提供課後複習與練習。
3. 直播錄影課程可重複觀看至最後一堂直播結束後 2 個月。

★ 上課證明：課程依班級評量方式達 70 分以上，並完成結訓意見調查表，將由陽明交通大學雷射系統研究中心核發上課證明。

■ 報名方式

1. 成為 STEM 與永續發展人才培訓會員：報名參加訓練課程前，請先於網站進行會員註冊。
(網站會員註冊：<https://it.stem.lasercenter.nycu.edu.tw/register>)
※註冊之信箱請務必以常用信箱為主，避免重要通知信件無法正常收件。
2. 會員登入後，選擇要報名之課程：選擇課程進入課程介紹頁面，點選課程介紹頁面上方之「我要報名」。
3. 購買課程步驟：

- (1.) 確認訂單資訊：請確認選擇報名之課程名稱、價格及開訓日期。
- (2.) 選擇付款方式：可選擇 ATM 付款或是信用卡線上刷卡，依指示步驟完成付款。
- (3.) 完成報名：成功付款後，將會出現訂單完成頁面，訂單狀態及繳費狀態將會顯示「成功」，並會寄發繳費成功通知信，請務必留意。
4. 查看課程：會員登入後，點選會員中心之「班級總覽」，可以查看已報名的課程資訊，包含開課後之課程連結及學習平台連結等。
5. 開訓前通知：開課前一周內將會寄發課前通知信，包含課程相關社群資訊、課程連結、課表及課程規定等重要資訊，請務必留意信箱。
- ※如未收到通知信，請務必來電或以 Line@ 進行確認，以免錯失重要資訊。
- ※開訓後，為保障線上課程學員權益，班級社群及上課登入皆採實名制，如以匿名方式加入，經通知屢次未修正，將取消加入社群及上課會議室資格，請務必留意！

■ 課程條款

學員報名後表示同意並遵守以下課程條款

1. 學員同意以下事項，若有違反任一條款，開課單位有權立即終止契約，並依退費條款退還款項，並保留追究法律責任的權利。
 - 學員應遵守課堂的基本秩序，包括但不限於：不打擾其他學員、不使用不當語言或行為、尊重授課教師及助教，若有違反上開規定且經制止而再犯者。
 - 學員應對所有授課教師、助教、工作人員保持尊重。任何形式的不當言語，如咒罵、咆哮、威脅、或人身攻擊均屬於不可接受的行為。
 - 學員以任何形式針對課程與開課單位進行惡意中傷或不實宣傳者。
2. 契約終止後，學員不得再參加開課單位所提供的任何課程或服務。
3. 學員同意開課單位，因課程執行或其他考量，可保留學員參加課程之權利，開課單位可將已經報名繳費的學員進行全額退費。
4. 開課單位保留隨時修改或更新本條款的權利，且毋須事先通知。學員若不同意修改後的條款，有權選擇終止契約，並依照退費條款進行退費。

■ 注意事項

1. 請各位學員自行準備筆電，並確保網路環境，以利上課所需。
2. 課程為直播授課，每堂課皆會錄影並上傳至學習平台供課後複習，為保護智財權，課程影片都有加密，建議使用 windows 系統+chrome 或 Mac+chrome 上課。(手機

或 ipad 平板無法看錄影課程

3. 退費說明：
 - (1.) 會員自報名課程至實際開課上課日前申請退費者，可全額退款。
 - (2.) 自實際開課上課日算起未逾全期三分之一者，退還已繳學費之半數。
 - (3.) 自實際開課上課日算起已逾全期三分之一者，不予退還。
 - (4.) 退費方式：請於退費期限內提出申請退費，ATM 繳費者需上傳本人身份證照片以及在台金融單位存摺照片。
4. 為尊重講師之智慧財產權益，依講師課程形式提供參考資料或電子檔，實際提供之課程教材與形式，以開課後，講師進行方式為準。
5. 為配合講師時間或臨時突發事件，主辦單位有調整日期或更換講師之權利。
6. 為確保課程內容的適配性，本課程僅開放給 55 歲以下的學員參加。

■ 課程大綱

課程名稱	課程內容	時數
半導體封裝	1. 晶片封裝 2. 封裝流程、常見封裝型態 3. 封裝產業鏈 4. 晶片發展趨勢	15
自動光學檢查 AOI	1. 光學檢測系統 2. 網路連接 3. 動力控制	6
光學概論與光電子學	1. 波動光學基礎與干涉、繞射 2. 光的偏振 3. 波導管介紹與分析 4. Fresnel Equation 介紹 5. LED 與光偵測器簡介	15
半導體微影技術	1. CMOS 基礎原理與應用 2. 微影製程導論 3. 多重圖案化	12
IC 製程計量與缺陷檢測	1. 品質度量與指標 2. 分析設備	6

顯示技術概論	1. 液晶顯示原理和色彩 2. LCD / LED	6
半導體設備介紹	1. 基礎設備維修與半導體知識 2. 核心半導體設備操作與維護 3. 微影與研磨技術基礎 4. 濕式化學處理與設備清潔 5. 設備控制檢測與維修	15
雷射應用	1. 雷射基礎原理/增益介質 2. 雷射激發光源 3. 雷射共振腔 4. 雷射應用	15
總計		90

※主辦單位保留調整課程內容與講師等之權利。

■ 課程規劃表

■ 課程時段：每週一、三晚上 18:30-21:30

每週六早上 9:00~12:00

■ 實際上課時間及課程連結以開訓前通知信為準

上課日期	課程名稱	時數
2026/1/31	半導體封裝晶片封裝概論	3
2026/2/2	光學概論與光電子學波動光學基礎與干涉、繞射	3
2026/2/4	光學概論與光電子學光的偏振	3
2026/2/7	半導體封裝傳統封裝(打線封裝)	3
2026/2/9	光學概論與光電子學 Fresnel Equation 介紹	3
2026/2/11	Aoi 簡介	3
2026/2/14	Aoi 簡介	3
2026/2/23	光學概論與光電子學波導管介紹與分析	3
2026/2/25	光學概論與光電子學 LED 與光偵測器簡介	3
2026/3/2	半導體設備介紹基礎設備維修與半導體知識	3
2026/3/4	雷射應用雷射基礎原理/增益介質	3

2026/3/7	半導體封裝基板介紹(載板)	3
2026/3/9	半導體設備介紹核心半導體設備操作與維護	3
2026/3/11	雷射應用雷射激發光源	3
2026/3/14	半導體封裝高階封裝(覆晶封裝)	3
2026/3/16	半導體設備介紹微影與研磨技術基礎	3
2026/3/18	半導體微影技術 CMOS 基礎原理與應用	3
2026/3/21	半導體封裝晶圓級封裝, 先進封裝	3
2026/3/23	半導體微影技術微影製程導論	3
2026/3/25	半導體設備介紹濕式化學處理與設備清潔	3
2026/3/28	雷射應用雷射共振腔	3
2026/3/30	半導體微影技術微影製程導論	3
2026/4/1	半導體設備介紹設備控制檢測與維修	3
2026/4/6	半導體微影技術解析度增強與多重圖案化	3
2026/4/8	IC 製程計量與缺陷檢測品質度量與指標	3
2026/4/11	雷射應用雷射應用	3
2026/4/13	IC 製程計量與缺陷檢測分析設備	3
2026/4/15	顯示技術導論顯示原理和色彩學	3
2026/4/18	雷射應用雷射應用	3
2026/4/20	顯示技術導論 LCD / LED	3
合計時數		90

※主辦單位保留調整課表日期與時段之權利。